



Final Product/Process Change Notification

Document #:FPCN22541X1

Issue Date:17 Apr 2020

Title of Change:	Update notice to FPCN22541X - Cancellation of Qualification of High Density Lead frame from 6rows to 16 rows and BOM Change for SMB Package in Sub-Contractor Factory Seeful for Schottky diodes as announced in FPCN22541X	
Proposed First Ship date:	Not Applicable	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or norsahida.sahman@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Lalan.Ortega@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	No Change	
Change Category:	No change	
Change Sub-Category(s):	No change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites
None		Liteon Semiconductor, Seeful
Description and Purpose:		
<p>This is an update notification of FPCN22541X. Due to the changing business conditions, ON Semiconductor decided not pursue the change made by our subcontractor factory (Shanghai Seeful) to qualify high density lead frame from 6-rows to 16 -rows for Schottky diodes including BOM change in SMB package.</p> <p>As a result of this announcement the BOM will remain as the original BOM.</p> <p>There are no product material changes as a result of this announcement.</p> <p>There is no product marking change as a result of this announcement.</p>		
Reliability Data Summary:		
Reliability data is not applicable for this announcement.		
Electrical Characteristics Summary:		
Electrical data is not applicable for this announcement.		

**List of Affected Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
MBRS1540T3G	MBRS260T3G
MBRS260T3G	MBRS260T3G
SS22T3G	MBRS260T3G
SS24T3G	MBRS260T3G
SS26T3G	MBRS260T3G
MBRS1100T3G	MBRS3200T3G
MBRS190T3G	MBRS3200T3G
MBRS2040LT3G	MBRS3200T3G
MBRS240LT3G	MBRS3200T3G
MBRS2H100T3G	MBRS3200T3G
MBRS3200T3G	MBRS3200T3G
MBRS360BT3G	MBRS3200T3G
MBRS120T3G	MBRS230LT3G
MBRS130LT3G	MBRS230LT3G
MBRS130T3G	MBRS230LT3G
MBRS140T3G	MBRS230LT3G
MBRS230LT3G	MBRS230LT3G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22541X1

発行日: 17 Apr 2020

変更件名:	FPCN22541X の更新通知- FPCN22541X で通知しました、外注工場 Seeful における SMB パッケージショットキーダイオードの 6 連から 16 連への高密度リードフレームの認定および部品表 (BOM) 変更の取り消し		
初回出荷予定日:	該当なし		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または norsahida.sahman@onsemi.com にお問い合わせください。		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。		
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または Lalan.Ortega@onsemi.com にお問い合わせください。		
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com 宛てにお願いします。		
変更部品の識別:	なし		
変更カテゴリ: なし			
変更サブカテゴリ: なし			
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:		外部製造工場 / 下請業者拠点:	
無し		Liteon Semiconductor, Seeful	
説明および目的:			
これは FPCN22541X の更新通知です。ビジネス条件の変更により、オン・セミコンダクターは外注工場 (上海 Seeful) における SMB パッケージの部品表 (BOM) 変更を含むショットキーダイオードの 6 連から 16 連への高密度リードフレームの認定を追求しないことを決めました。 この通知により、部品表 (BOM) は引き続き元の部品表 (BOM) となります。 今回の通知に伴う製品材料の変更はありません。 今回の通知に伴う製品マーキングの変更はありません。			
信頼性データの要約:			
今回の通知には信頼性データは適用されません。			
電気的特性の要約:			
今回の通知には電気的特性データは適用されません。			



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22541X1

発行日: 17 Apr 2020

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
MBRS1540T3G	MBRS260T3G
MBRS260T3G	MBRS260T3G
SS22T3G	MBRS260T3G
SS24T3G	MBRS260T3G
SS26T3G	MBRS260T3G
MBRS1100T3G	MBRS3200T3G
MBRS190T3G	MBRS3200T3G
MBRS2040LT3G	MBRS3200T3G
MBRS240LT3G	MBRS3200T3G
MBRS2H100T3G	MBRS3200T3G
MBRS3200T3G	MBRS3200T3G
MBRS360BT3G	MBRS3200T3G
MBRS120T3G	MBRS230LT3G
MBRS130LT3G	MBRS230LT3G
MBRS130T3G	MBRS230LT3G
MBRS140T3G	MBRS230LT3G
MBRS230LT3G	MBRS230LT3G